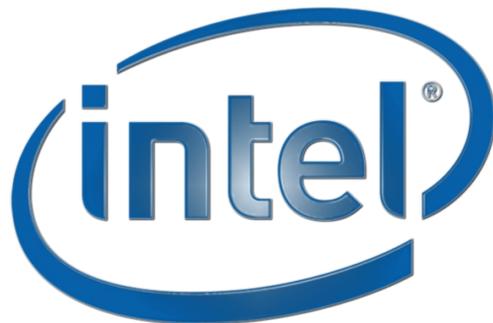
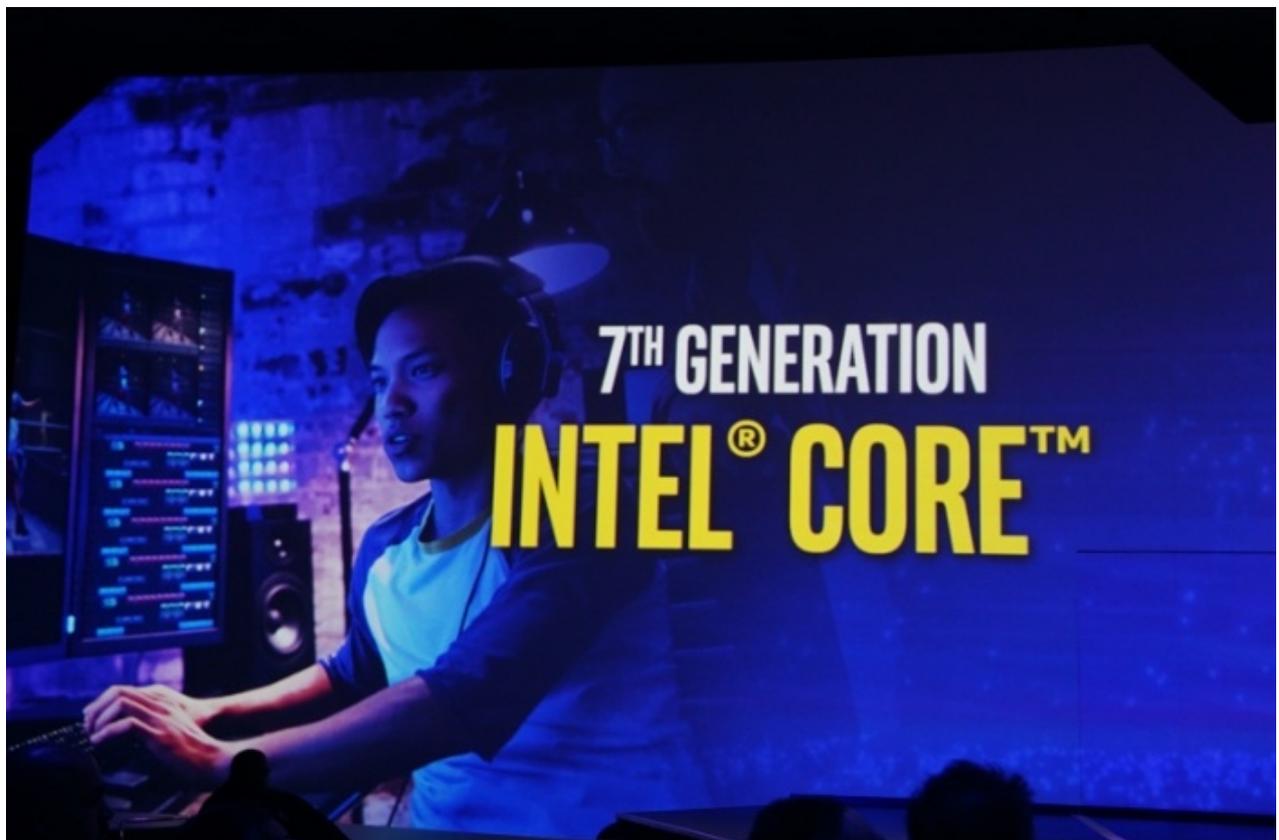


Svelati modelli e specifiche di Kaby Lake-S



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/7673/svelati-modelli-e-specifiche-di-kaby-lake-s.htm>)

Saranno 10 le CPU desktop che arriveranno sugli scaffali nel primo trimestre del 2017.



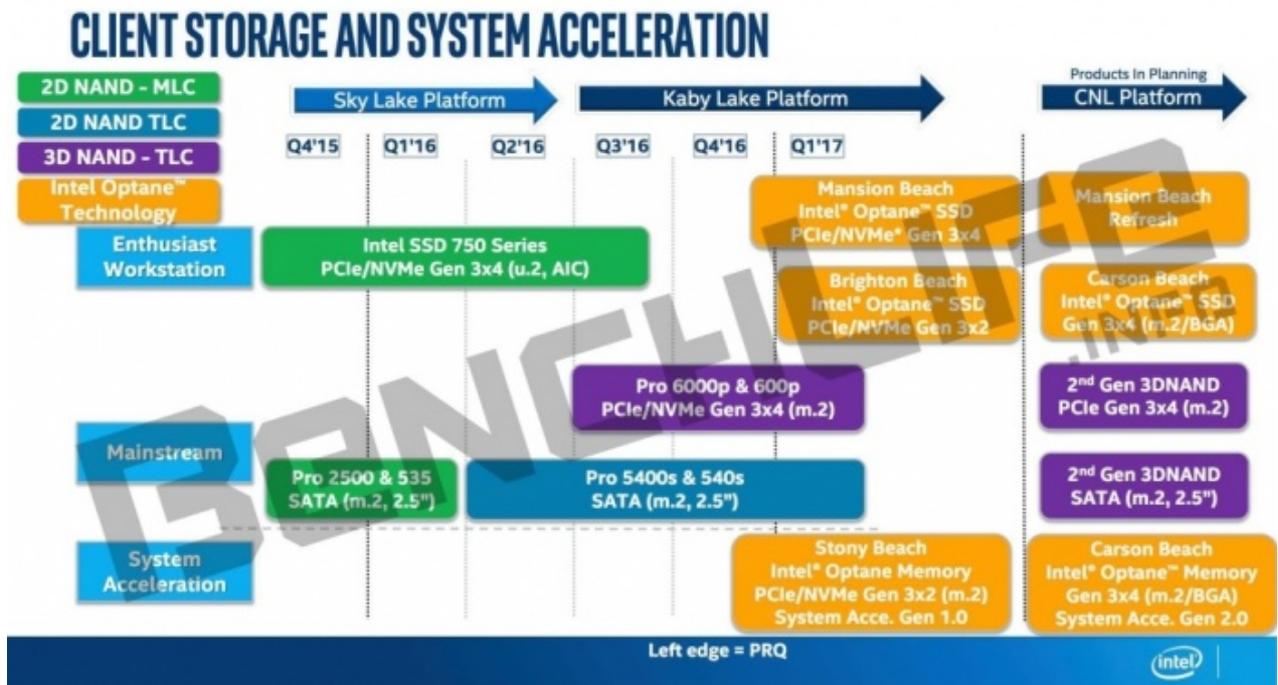
Nonostante il riserbo di Intel, che anche in occasione dell'IDF di San Francisco è rimasta molto abbottonata lasciandosi solo sfuggire di aver cominciato a spedire verso gli OEM le prime soluzioni mobile, ci ha pensato [Coolaler.com](http://www.coolaler.com/content.php/6761) (<http://www.coolaler.com/content.php/6761>) ad anticipare quella che sarà la lineup completa di Kaby Lake per i modelli desktop.

Certo, la priorità per Intel è al momento rappresentata dalle CPU mobile di 7^o generazione con un TDP compreso tra i 4 ed i 15W che, in linea di massima, dovrebbero essere tutte completamente disponibili entro la fine dell'anno in corso, ma, a ruota, toccherà alle versioni desktop in versione "S" anticipate al Q1 2017.

Fugati i dubbi per quanto concerne la nomenclatura, per cui Kaby Lake-X sarà solo la variante HEDT sul nuovo socket LGA 2066 (che debutterà con Skylake-X), Kaby Lake-S, ovvero la produzione mainstream che continuerà ad utilizzare il socket LGA 1151, sarà rilasciato in 10 differenti SKU di cui due con moltiplicatore sbloccato (K).

Architettura Processore	Sandy Bridge	Ivy Bridge	Haswell	Broadwell	Skylake	Kaby Lake	Cannonlake
Processo Produttivo	32nm	22nm	22nm	14nm	14nm	14nm	10nm
Numero Core Max	4	4	4	4	4	4	TBA
Chipset	Cougar Point	Panther Point	Lynx Point	Wild Cat Point	Sunrise Point	Union Point	TBA
Socket LGA	1155	1155	1150	1150	1151	1151	TBA
Memorie	DDR3	DDR3	DDR3	DDR3	DDR4/DDR3L	DDR4/DDR3L	DDR4
TDP	35-95W	35-77W	35-84W	65W	35-95W	35-95W	TBA
Lancio	2011	2012	2013-2014	2015	2015	2016	2017

Kaby Lake sarà solo un affinamento di Skylake e, a quanto pare, fatta eccezione per una efficienza leggermente migliorata, non offrirà vantaggi significativi (al massimo un incremento compreso tra un 5 ed un 10%) se non per quanto concerne le prestazioni di I/O.



Con l'introduzione dei chipset serie 200 (Z270, H270, Q270, Q250 e B250), infatti, sarà sfruttata la velocità offerta dalle periferiche di storage Intel Optane, SSD e DIMM, grazie all'avanzata architettura 3D XPoint.

Le caratteristiche di base di Union Point includeranno il supporto sino a 24 linee PCI-E (contro le 20 offerte dai chipset 100 Sunrise Point), sei porte SATA 3.0 e 10 USB 3.0.

Modello CPU	Core	Thread	Clock	Cache	TDP	Socket
Core i7-7700K	4	8	4,2GHz	8M	95W	LGA 1151
Core i7-7700	4	8	3,6GHz	8M	65W	LGA 1151
Core i7-7700T	4	8	2,9GHz	8M	35W	LGA 1151

Core i5-7600K	4	4	3,8GHz	6M	95W	LGA 1151
Core i5-7600	4	4	3,5GHz	6M	65W	LGA 1151
Core i5-7600T	4	4	2,8GHz	6M	35W	LGA 1151
Core i5-7500	4	4	3,4GHz	6M	65W	LGA 1151
Core i5-7500T	4	4	2,7GHz	6M	35W	LGA 1151
Core i5-7400	4	4	3GHz	6M	65W	LGA 1151
Core i5-7400T	4	4	2,4GHz	6M	35W	LGA 1151

La GPU integrata sarà sostanzialmente una replica della GT2 presente sull'attuale 6700K, ovvero la HD Graphics 530 dotata di 24 EUs con una frequenza dinamica massima fissata in 1150MHz.